

podtrzymującą oczyszczane złoże (3), od dołu połączoną z rurociągiem (4) sprzężonym z dmuchawą (5), którego przestrzeń wewnętrzna połączona jest z generatorem (8) ozonu. Pomiedzy generatorem (8) ozonu, a reaktorem (1) wbudowana jest, jako fragment rurociągu (4), płuczka (5) z zalkalizowaną wodą do pH 10. Drugie rozwiązanie tego urządzenia ma przed wlotem do dmuchawy usytuowany ultradźwiękowy wytwarzacz aerozolu wody.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **403373** (22) 2013 03 29

(51) **B23K 35/36** (2006.01)
B23K 35/362 (2006.01)
B23K 35/363 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY,
 Warszawa
 (72) KOŚCIELSKI MAREK; RAFALIK IRENEUSZ;
 SITEK JANUSZ; KAROLEWSKI SEBASTIAN

(54) Topnik typu no-clean do lutowania selektywnego

(57) Topnik (typu no-clean) do lutowania selektywnego, charakteryzuje się tym, że zawiera rozpuszczalnik, korzystnie propan-2-ol i/lub kwas karboksylowy i/lub kwasy kalafonii, oraz amid organiczny w ilości co najwyżej 20%.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **403443** (22) 2013 04 05(51) **B23P 17/04** (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
 Kraków
 (72) KAWECKI ARTUR; KNYCH TADEUSZ;
 MAMAŁA ANDRZEJ; KWAŚNIEWSKI PAWEŁ;
 KIESIEWICZ GRZEGORZ; SMYRAK BEATA;
 SIEJA-SMAGA ELIZA

(54) Sposób wytwarzania drutów ze stopów Cu-Ag

(57) Sposób wytwarzania drutów, w tym mikrodrutów, ze stopów Cu-Ag, zwłaszcza ze stopów Cu-(3÷7,9)%wag. Ag, polega na tym, że materiały w postaci miedzi i srebra o wysokiej czystości chemicznej poddawane są procesowi topienia w temperaturze 1083÷1300°C w tyglu grafitowym umieszczonym w piecu, a następnie procesowi odlewania ciągłego w temperaturze 1083÷1300°C, w atmosferze gazu obojętnego przy zastosowaniu krystalizatora grafitowego, w warunkach chłodzenia pierwotnego (chłodzenie krystalizatora) oraz wtórnego (zakrzepniętego stopu po wyjściu z krystalizatora). Tak otrzymany odlew poddany jest obróbce cieplno-mechanicznej.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) **403444** (22) 2013 04 05(51) **B23P 17/04** (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
 IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
 Kraków
 (72) KAWECKI ARTUR; KNYCH TADEUSZ;
 MAMAŁA ANDRZEJ; KWAŚNIEWSKI PAWEŁ;
 KIESIEWICZ GRZEGORZ; SMYRAK BEATA;
 SIEJA-SMAGA ELIZA

(54) Sposób wytwarzania drutów ze stopów Cu-Ag

(57) Sposób wytwarzania drutów, w tym mikrodrutów, ze stopów Cu-Ag, zwłaszcza ze stopów Cu-(8÷15)% wag. Ag, polegający na tym, że materiały w postaci miedzi i srebra o wysokiej czystości chemicznej poddawane są procesowi topienia w temperaturze 1083÷1300°C w tyglu grafitowym umieszczonym w piecu, a następnie procesowi odlewania ciągłego w temperaturze 1083÷1300°C, w atmosferze gazu obojętnego przy zastosowaniu krystalizatora grafitowego, w warunkach chłodzenia pierwotnego (chłodzenie

krystalizatora) oraz wtórnego (zakrzepniętego stopu po wyjściu z krystalizatora). Tak otrzymany odlew poddany jest obróbce cieplno-mechanicznej.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) **403506** (22) 2013 04 11

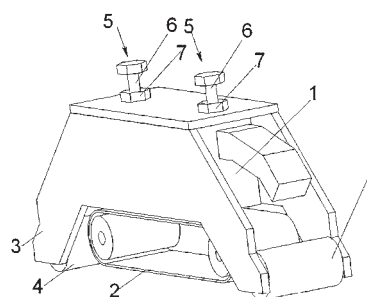
(51) **B24B 23/08** (2006.01)
B24B 23/06 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
B29D 30/52 (2006.01)

(71) SZAFRAŃSKI PIOTR, Warszawa
 (72) SZAFRAŃSKI PIOTR

(54) Urządzenie do naprawy opon

(57) Urządzenie do naprawy opon, zawiera element ścierny, który stanowi pas szlifierski (2) szlifierki taśmowej (1). Szlifierka taśmowa (1) z pasem szlifierskim (2) osadzona jest ruchomo w ramie prowadzącej (3).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **403446** (22) 2013 04 05

(51) **B27M 3/18** (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)

(71) TABESKO
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Łódź
 (72) POROWSKI JAN

(54) Płyta meblowa i sposób wytwarzania płyt meblowych

(57) Sposób wytwarzania płyt meblowych, w którym na pierwszej warstwie okładziny powierzchni głównej z naniesionym na nią klejem układa się sztywną ramę, w której umieszcza się papierowe wypełnienie, po czym nakłada się na nie drugą warstwę okładziny powierzchni głównej z naniesionym na nią klejem i tak ułożone warstwy prasuje się uzyskując płytę o strukturze komórkowej charakteryzuje się tym, że ramiaki (21-24) ramy (20) szlifuje się do znormalizowanej wysokości (h1) od 10mm do 60mm, a papierowe wypełnienie (30) przygotowuje się w postaci wstęgi tak, że z arkuszy tektury falistej wycina się, w kierunku prostopadłym do kierunku fali, paski o szerokości większej od wysokości (h1) ramiaków (21-24) o wielkość do 0,5mm, które to paski łączą się we wstęgę, przy czym wstęgę układa się kierunkiem fali prostopadle do okładzin (11, 12)

